

证券代码:002185

证券简称:华天科技

公告编号:2025-033

天水华天科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了进一步加强在先进封装领域的竞争能力，满足未来战略发展需要，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司华天科技（江苏）有限公司（以下简称“华天江苏”）、全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“华天昆山”）及全资下属合伙企业华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“先进壹号”）共同出资，设立全资子公司南京华天先进封装有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简称“华天先进”）。拟新设公司注册资本总额 200,000 万元，其中华天江苏认缴出资 100,000 万元，占比 50%，华天昆山认缴出资 66,500 万元，占比 33.25%，先进壹号认缴出资 33,500 万元，占比 16.75%。

本次对外投资事项已经公司 2025 年 8 月 1 召开的第八届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属公司董事会审批权限，无需股东大会批准。

本次对外投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要出资主体介绍

1、全资子公司华天科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320111MA27EJ3N21

住所：南京市浦口区丁香路 18 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：肖智轶

注册资本：125000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；电子元器件零售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司间接持有其100%股权。

2、全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司

统一社会信用代码：913205836754951362

住所：江苏省昆山开发区龙腾路 112 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：肖智轶

注册资本：184017.803901 万元人民币

经营范围：研发、制造、封装和测试集成电路；销售自产产品并提供相关服务；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：公司持有其 100%的股权。

3、全资下属合伙企业华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320111MAERL8HA36

主要经营场所：江苏省南京市浦口区丁香路 18 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：华天先进贰号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：肖智轶）

认缴出资总额：3800 万元

经营范围：股权投资、企业管理咨询、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：华天先进贰号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“先进贰号”）作为普通合伙人持有其 98.68%的份额，华天昆山作为有限合伙人持有其 1.32%的份额。其中，先进贰号由华天江苏作为普通合伙人持有其 0.10%的份额，华天昆山作为有限合伙人持有其 99.90%的份额。因此，公司间接持有先进壹号 100%的份额。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

华天江苏以现金及机器设备、土地房产等方式出资，华天昆山及先进壹号以现金方式出资。现金方式出资的资金来源为自有资金。

2、标的企业基本情况

- (1) 拟定名称：南京华天先进封装有限公司
- (2) 拟注册地点：南京市
- (3) 拟从事的业务：2.5D/3D集成电路封装测试
- (5) 股权结构：

出资人	出资额（万元）	认缴比例
华天科技（江苏）有限公司	100,000.00	50.00%
华天科技（昆山）电子有限公司	66,500.00	33.25%
华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）	33,500.00	16.75%
合计	200,000.00	100%

以上信息将以登记机关登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

近年来，随着高性能运算、人工智能、数据中心、自动驾驶、智能手机、5G通信等领域对芯片算力需求的日益增强，带动了集成电路先进封装的快速发展。同时，随着 7nm 以下制程成本急剧攀升，单纯依靠制程微缩提升性能的路径难以为继，而先进封装已成为延续摩尔定律的关键，并成为当前半导体行业发展的主

要驱动力之一。目前，台积电、英特尔、三星等国际巨头纷纷将先进封测列为其战略重点，全球产业链加速向先进封测倾斜，技术成熟度与产业化能力持续提升，为规模化应用奠定了基础。2025 年全球先进封装市场预计总营收为 569 亿美元，同比增长 9.6%；市场规模预计将在 2028 年达到 786 亿美元，2022—2028 年间年化复合增速达 10.05%。根据预测，2027 年全球先进封装市场规模占比将首次超过传统封装。

为了在集成电路先进封装市场竞争中抢抓先机，公司拟设立华天先进，华天先进以 2.5D/3D 等先进封装测试为主营业务。该公司设立后，将进一步加大 2.5D/3D 等先进封测业务领域的投入，加快推动先进封装业务的发展，扩大先进封测产业规模 and 市场份额，增强公司整体竞争能力，巩固和提升公司行业地位。

2、存在的风险

拟设公司运营过程中可能会因宏观经济环境以及自身经营情况不达预期等因素的影响而产生一定的运营风险。

3、对公司的影响

各出资主体将根据拟设公司业务进展情况缴纳出资，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。拟设公司的成立将有利于推动公司在先进封装领域的布局，完善公司封测技术工艺及业务体系，符合公司的整体发展战略，对公司未来发展具有积极的推动作用。

备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二日